

# XR-50B 规格书

版本 V1.2

版权 ©2019

## 免责声明和版权公告

本文中的信息，包括供参考的 URL 地址，如有变更，恕不另行通知。

文档“按现状”提供，不负任何担保责任，包括对适销性、适用于特定用途或非侵权性的任何担保，和任何提案、规格或样品在他处提到的任何担保。本文档不负任何责任，包括使用本文档内信息产生的侵犯任何专利权行为的责任。本文档在此未以禁止反言或其他方式授予任何知识产权使用许可，不管是明示许可还是暗示许可。

文中所得测试数据均为机芯实验室测试所得，实际结果可能略有差异。

Wi-Fi 联盟成员标志归 Wi-Fi 联盟所有。

文中提到的所有商标名称、商标和注册商标均属其各自所有者的财产，特此声明。

最终解释权归深圳市机芯智能有限公司所有。

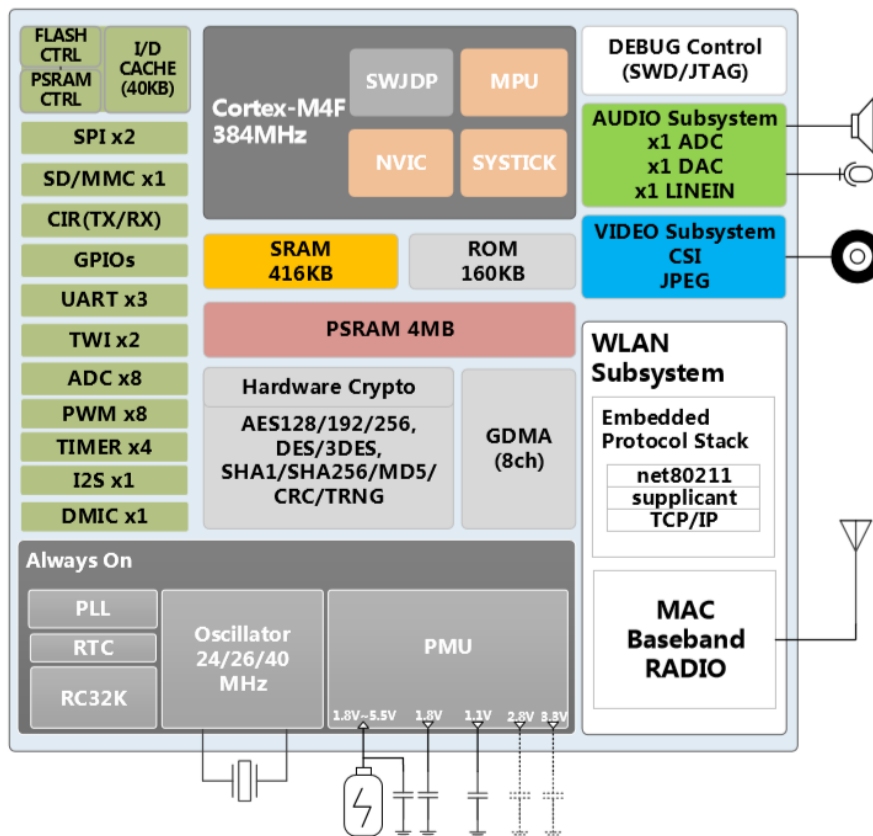
## 注 意

由于产品版本升级或其他原因，本手册内容有可能变更。深圳市机芯智能有限公司保留在没有任何通知或者提示的情况下对本手册的内容进行修改的权利。本手册仅作为使用指导，深圳市机芯智能有限公司尽全力在本手册中提供准确的信息，但是深圳市机芯智能有限公司并不确保手册内容完全没有错误，本手册中的所有陈述、信息和建议也不构成任何明示或暗示的担保。

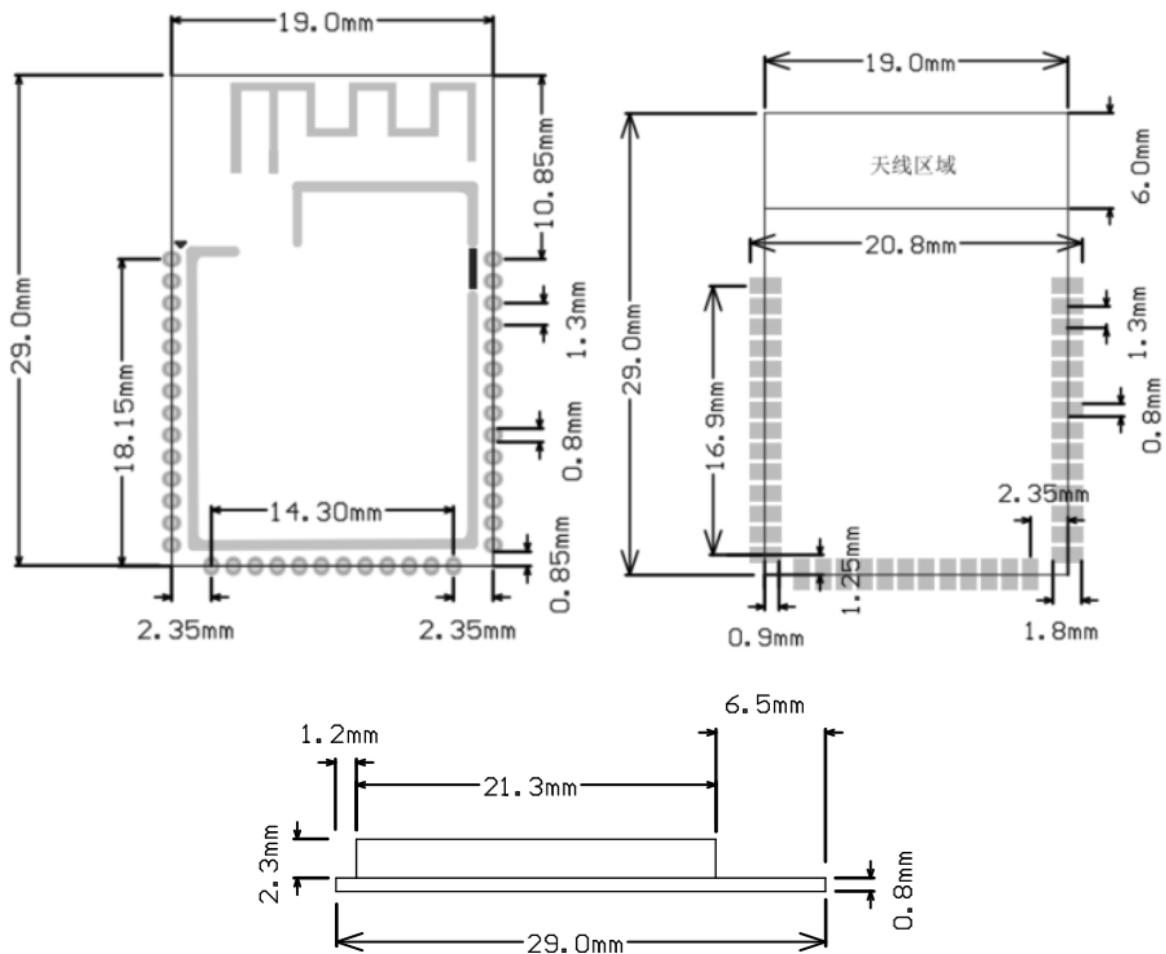
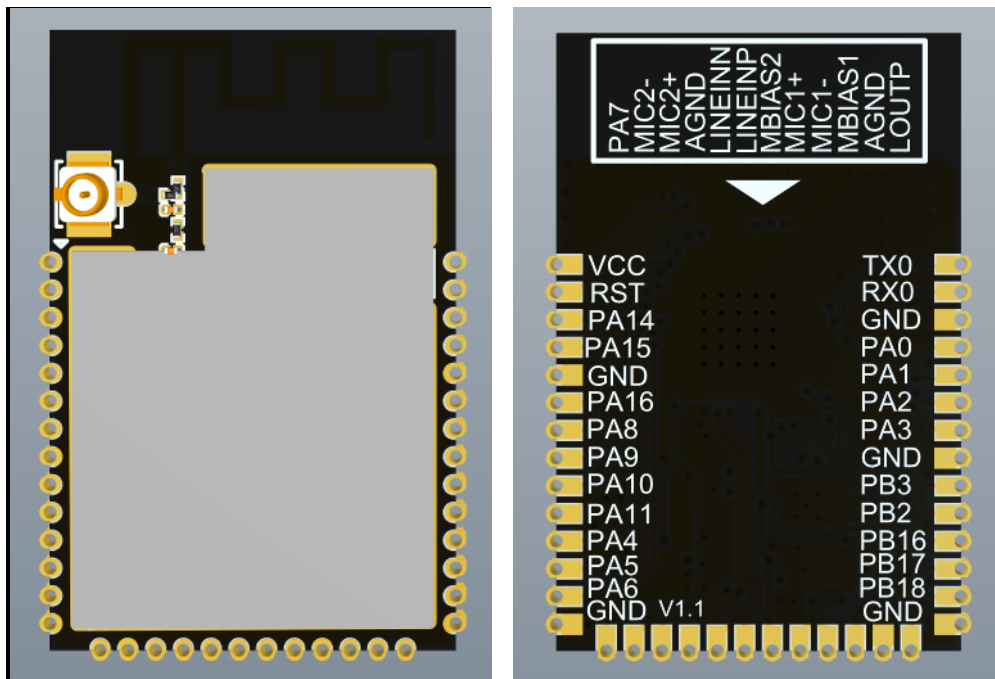
## 1、产品概述

XR-50B WiFi 模组主要是为较高性能的语音识别、音频播放及 WiFi 无线应用而开发，该模组由核心处理器 XR872AT、AC107 音频 CODEC 及电源等外围电路组成，XR872AT 是在较小尺寸封装中集成了运行频率高达 384MHz 的 ARM Cortex-M4F MCU 和大容量 SRAM。XR872A 是一款高度集成的低功耗 Wi-Fi 微控制器 SoC，支持 RTOS，集成 Wi-Fi MAC/BB/RF/PA/LNA，高性能和高度集成的 MCU，使软件能够执行更复杂的任务，支持 AES/DES/3DES/SHA/MD5/CRC 等硬件加密引擎，使数据传输更安全、更快。采用 XRADIOTECH 的 MPDPTM 技术设计的新型数字 RF 发射机可提供更高的输出功率并保持更高的效率，保持芯片对天线失配不敏感，但在不同的 VSWR 下始终具有良好的 EVM。它还包括许多外设，包括 UART，TWI，SPI，DMIC，Audio Codec，PWM，CIR（T / R），CSI，SDIO 和 ADC。

XR-50B WiFi 模组支持标准的 IEEE802.11 b/g/n 协议，具有完整的 TCP/IP 协议栈。用户可以使用该模组为现有的设备添加联网功能，也可以使用其构建独立的网络控制器。在搭载应用并作为设备中唯一的应用处理器时，能够直接从外接闪存中启动。内置的高速缓冲存储器有利于提高系统性能，并减少内存需求。



## 1.1 外观尺寸



## 1.2 特性

- 支持 IEEE 802.11b/g/n, 1x1 SISO 2.4GHz
- 内置 ARM Cortex-M4F 的 32 位微型 MCU, 主频高达 384MHZ
- 内置 416KB 的 SRAM, 160KB 的 ROM 和 4MB 的 PSRAM
- 支持外置 Flash 和 eXecute In Place(XIP) 模式
- 内置 1024 bits 的 efuse
- 8 路共享的通用 DMA 通道
- 内置 8 路 12 位分辨率和 10 位有效 SAR 型 A / D 转换器, 其中 7 路普通通道, 1 路 VBAT 电压检测通道
- 集成 Wi-Fi MAC/ BB/RF/PA/LNA
- 支持 WEP, WPA/WPA2, WPS2.0
- 支持 UART/GPIO/ADC/PWM/I2C/I2S/SPI/CSI 接口
- 支持 AES/DES/3DES/SHA/MD5/CRC 加密引擎
- 支持 STA/AP/STA+AP 工作模式
- 支持 Smart Config/AirKiss (微信) 一键配网
- 支持串口本地升级和远程固件升级 (FOTA)
- 通用 AT 指令可快速上手
- 支持二次开发, 集成了 Windows、Linux 开发环境
- 板载 AC107 音频 CODEC 电路, 支持双驻极体麦

### 1.3 主要参数

表 1.1 主要参数说明

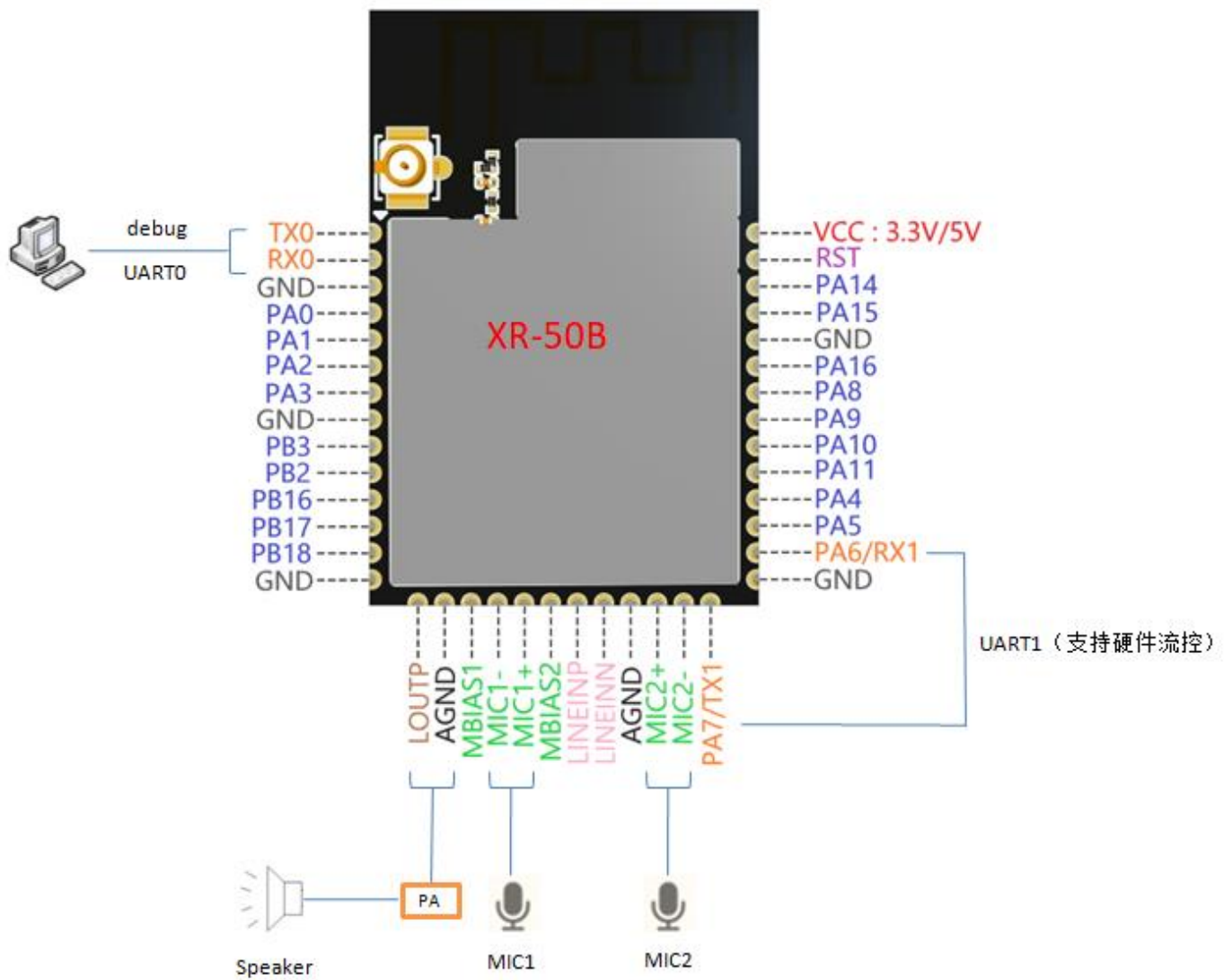
模块型号	XR-50B
封装	SMD40
尺寸	29*19*3(±0.2)mm
认证	FCC、CE、SRRC、REACH、RoHS
SPI Flash	默认 32Mbit
支持接口	UART/GPIO/ADC/PWM/I2S/SPI/SDIO/DVP/PDM
IO 口	26
串口速率	9600/19200/38400/115200/921600 bps
频谱范围	2400 ~2483.5MHz
天线形式	板载 PCB 天线/IPEX 外接天线
发射功率	802.11b: 17±2 dBm (@11Mbps) 802.11g: 15±2 dBm (@54Mbps) 802.11n: 14±2 dBm (@HT20, MCS7)
接收灵敏度	CCK, 1 Mbps : -96dBm CCK, 11 Mbps: -91dBm 6 Mbps (1/2 BPSK): -91dBm

	54 Mbps (3/4 64-QAM): -75dBm  HT20, MCS7 (65 Mbps, 72.2 Mbps): -72dBm
功耗（典型值）	RX Active(MCU active, DC-DC mode):44mA  TX Active(MCU active, DC-DC mode):  196mA@11n MCS7 15dBm  227mA@11b CCK 17dBm  Standby: ~43uA  Hibernation: ~5uA  Shutdown: ~0.5uA
安全性	WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK/WPS2.0
供电范围	供电电压 2.7V ~ 5.5V，供电电流 >600mA
工作温度	-40 °C ~ 85°C
存储环境	-65 °C ~ 150°C ,< 90%RH

## 2、管脚定义

XR-50B 模组共接出 40 个接口，如图 2.1，表 2.2 是接口定义。

图 2.1XR-50B 管脚示意图



XR-50B 外接两个 MIC、一个喇叭即可实现语音控制功能；MIC 间距推荐 30mm~70mm，可根据需求接 4 欧 0.5W~3W 的喇叭。



表 2.2 管脚功能定义

序号	Pin 脚名称	功能说明
1	TX0	UART0_TX; JTAG_TMS; PWM4/ECT4; SWD_TMS; EINTB0
2	RX0	UART0_RX; JTAG_TCK; PWM5/ECT5; SWD_TCK; EINTB1
3	GND	数字地
4	PA0	SPI1_MOSI ; SD_CMD; TWI1_SCL; CSI_D0; EINTA0
5	PA1	SPI1_MISO; SD_DATA0 ; TWI1_SDA; CSI_D1; EINTA1
6	PA2	SPI1_CLK ; SD_CLK ; CSI_D2; UART0_TX; EINTA2
7	PA3	SPI1_CS0; SD_DATA1; CSI_D3; UART0_RX; EINTA3 PA18;TWI0_SDA;IR_TX;FEM_CTRL2;IR_RX;EINTA18
8	GND	数字地
9	PB3	SWD_TCK; JTAG_TDI; PWM7/ECT7 ;FLASH_HOLD/IO; EINTB3
10	PB2	SWD_TMS; JTAG_TDO ;PWM6/ECT6; FLASH_WP/IO2; EINTB2
11	PB16	SD_CMD;EINTB16
12	PB17	SD_DATA0;EINTB17
13	PB18	SD_CLK;EINTB18
14	GND	数字地
15	LOUTP	编解码器 DAC 输出 p
16	AGND	模拟地

17	MBIAS1	麦克风 1 偏置电压输出 （默认不支持硅麦，悬空）
18	MIC1-	模拟麦 1 负极
19	MIC1+	模拟麦 1 正极
20	MBIAS2	麦克风 2 偏置电压输出 （默认不支持硅麦，悬空）
21	LINEINP	编解码器 line-in 输入 p
22	LINEINN	编解码器 line-in 输入 n
23	AGND	模拟地
24	MIC2+	模拟麦 2 正极
25	MIC2-	模拟麦 2 负极
26	PA7	UART1_TX;SPI1_CS2;TWI0_SDA;CSI_D7;WUPIO3;EINTA7
27	GND	数字地
28	PA6	UART1_RX;SPI1_CS1;TWI0_SCL;CSI_D6;WUPIO2;EINTA6
29	PA5	UART1_CTS;SD_DATA3;TWI0_SDA;CSI_D5;WUPIO1;EINTA5
30	PA4	UART1_RTS;SD_DATA2;TWI0_SCL;CSI_D4;WUPIO0;EINTA4
31	PA11	ADC_CH1;PWM3/ECT3;DMIC_DATA;CSI_VSYNC;EINTA11
32	PA10	ADC_CH0;PWM2/ECT2;DMIC_CLK;CSI_HSYNC;EINTA10
33	PA9	FEM_CTRL2;PWM1/ECT1;TWI1_SDA;CSI_MCLK;EINTA9
34	PA8	FEM_CTRL1;PWM0/ECT0;TWI1_SCL;CSI_PCLK;EINTA8
35	PA16	ADC_CH6;IR_RX ;I2S_LRCLK;UART1_RTS;EINTA16

36	GND	数字地
37	PA15	ADC_CH5;PWM7/ECT7;I2S_DO; UART1_CTS;EINTA15
38	PA14	ADC_CH4 ; PWM6/ECT6 ; I2S_DI ; UART1_RX;EINTA14
39	RST	复位
40	VCC	芯片输入电源，输入电压 2.7~5.5V，典型 5V/3.3V

表 2.3 XR 系列模组启动模式说明

模式	RST	PB2	PB3
下载模式	上升沿	低	低
运行模式	上升沿	低	高
		高	低
		高	高

注意：PB2、PB3 在芯片已内部上拉，RST 在模组上已上拉

### 3. 电气参数

#### 3.1 电气特性

参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
存储温度	-	-65	正常温度	150	℃
工作温度	-	-40	20	85	℃

最大焊接温度		IPC/JEDEC J-STD-020	-	-	260	°C
供电电压		VCC	2.7	3.3/5	5.5	V
I/O	V <sub>IL</sub>	VDD_IO=3.3V	-0.3	-	1.32	V
	V <sub>IH</sub>	VDD_IO=3.3V	2.06	-	3.6	V
	V <sub>OL</sub>	VDD_IO=3.3V, IOL =7.5 ~50 mA	-0.3	-	0.4	V
	V <sub>OH</sub>	VDD_IO=3.3V, IOL =7.5 ~50 mA	2.9	-	3.6	V

### 3.2Wi-Fi 射频

VCC=3.3V, VDD\_ANA=1.8V, XTAL=40MHz,温度=25°C

描述	最小值	典型值	最大值	单位
输入频率	2400	-	2483.5	MHz
输入反射值	-	-	-10	dB
<b>输出功率</b>				
CCK, 1 Mbps	17.05	17.34	-	dBm
CCK, 11.0 Mbps	16.62	17.07	-	dBm
6 Mbps OFDM	16.03	16.55	-	dBm
54Mbps OFDM	15.67	16.34	-	dBm

HT20, MCS0	14.34	15.88	-	dBm
HT20, MCS7	14.58	15.74	-	dBm
EVM				
CCK, 1 Mbps	-19.78	-19.91	-	dB
CCK, 11.0 Mbps	-18.71	-19.12	-	dB
6 Mbps OFDM	-21.23	-21.77	-	dB
54Mbps OFDM	-21.35	-22.41	-	dB
HT20, MCS0	-28.17	-28.48	-	dB
HT20, MCS7	-28.86	-30.22	-	dB
接收灵敏度				
CCK, 1 Mbps	-	-96	-	dBm
CCK, 11 Mbps	-	-91	-	dBm
6 Mbps	-	-91	-	dBm
54 Mbps	-	-75	-	dBm
HT20, MCS0	-	-91	-	dBm
HT20, MCS7	-	-72	-	dBm

### 3.3 音频编解码

VCC=3.3V, VDD\_ANA=1.8V, 温度=25℃ ,ADC 指标

参数	描述	性能			
		Min.	Typ.	Max.	Unit
Full-Scale Input Level	PGAGain=0dB@THD<-40dB	-	1.75	-	Vrms
SNR (A-weighted)	PGA Gain=0dB	-	100	-	dB
THD+N (-3dBFS 1KHz input)		-	-90	-	dB
SNR (A-weighted)	PGA Gain=24dB	-	94	-	dB
THD+N (-3dBFS 1KHz input)		-	-91	-	dB
SNR (A-weighted)	PGA Gain=36dB	-	84	-	dB
THD+N (-3dBFS 1KHz input)		-	-81	-	dB

VCC=3.3V, VDD\_ANA=1.8V, 温度=25℃ ,Line-in 指标

参数	描述	性能			
		Min.	Typ.	Max.	Unit
Full-Scale Input Level	PGAGain=0dB@THD<-40dB	-	1.8	-	Vrms
SNR (A-weighted)	PGA Gain=0dB	-	99	-	dB
THD+N (-3dBFS		-	-89	-	dB

1KHz input)					
SNR (A-weighted)	PGA Gain=24dB	-	91	-	dB
THD+N (-3dBFS 1KHz input)		-	-69	-	dB

VCC=3.3V, VDD\_ANA=1.8V, 温度=25°C ,DAC 指标

参数	描述	性能			
		Min.	Typ.	Max.	Unit
Full-Scale Output Level	RLoad=100K	-	0.856	-	Vrms
SNR (A-weighted)		-	99	-	dB
THD+N (-3dBFS 1KHz input)		-	-87	-	dB

### 3.4 功耗

XR872, 25°C, VCC=3.3V,VDD\_ANA=1.8V, MCU 384MHz

模式	MCU 状态	WLAN 状态	TX/RX	测试条件		最小值	典型值	最大值	单位
ACTIVE	Active	Active	TX	1M DSSS	17dBm	-	217.0	-	mA
				11M CCK	17dBm	-	226.6	-	mA
				6M OFDM	16dBm	-	214.0	-	mA
				54M OFDM	16dBm	-	218.0	-	mA
				HT20,M CS0	16dBm	-	201.3	-	mA
				HT20,M	15dBm	-	196.0	-	mA

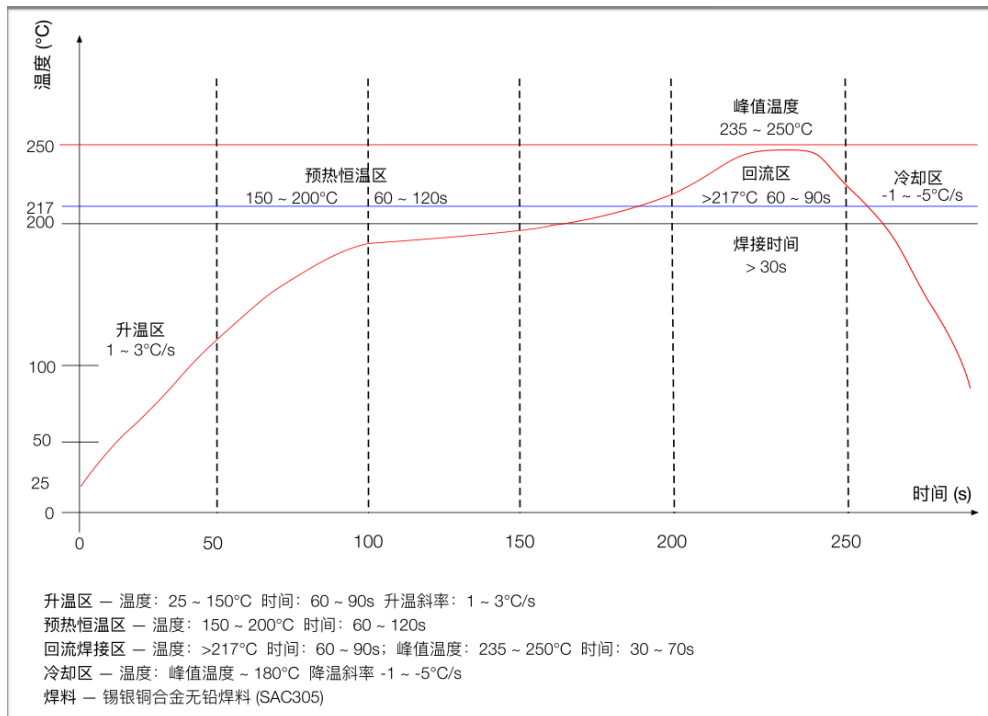
			RX	CS7					
				1M DSSS		-	40.0	-	mA
				11M CCK		-	42.0	-	mA
				54M OFDM		-	48.5	-	mA
				HT20,MCS0		-	48.3	-	mA
				HT20,MCS7		-	48.0	-	mA
STANDBY	Sleep	Active	TX	1M DSSS, null frame	17dBm	-	217.0	-	mA
				RX listen		-	40.0	-	mA
		PS Mode	RX	1M DSSS		-	32.5	-	mA
				DTIM1		-	1031.0	-	uA
				DTIM3		-	428.0	-	uA
				DTIM8		-	186.0	-	uA
				DTIM10		-	154.0	-	uA
		OFF	-	-		-	43.0	-	uA
HIBERNATION	OFF	OFF	-	-		-	5.0	-	uA
SHUTDOWN	OFF	OFF	-	-		-	0.5	-	uA

### ★说明：

- ACTIVE 模式，MCU 和 WLAN 都处于活跃状态，测试 RX 和 TX 分别处于不同发射功率下的功耗大小。
- STANDBY 模式，MCU 处于睡眠状态，等待外设中断唤醒。例如：在系统长时间无任务而又需要联网时，关闭多数外设，保留网络通信能力，在收到数据时，能尽快唤醒系统进行处理。
- HIBERNATION 模式只保留 RTC，等待定时器或唤醒 IO 中断

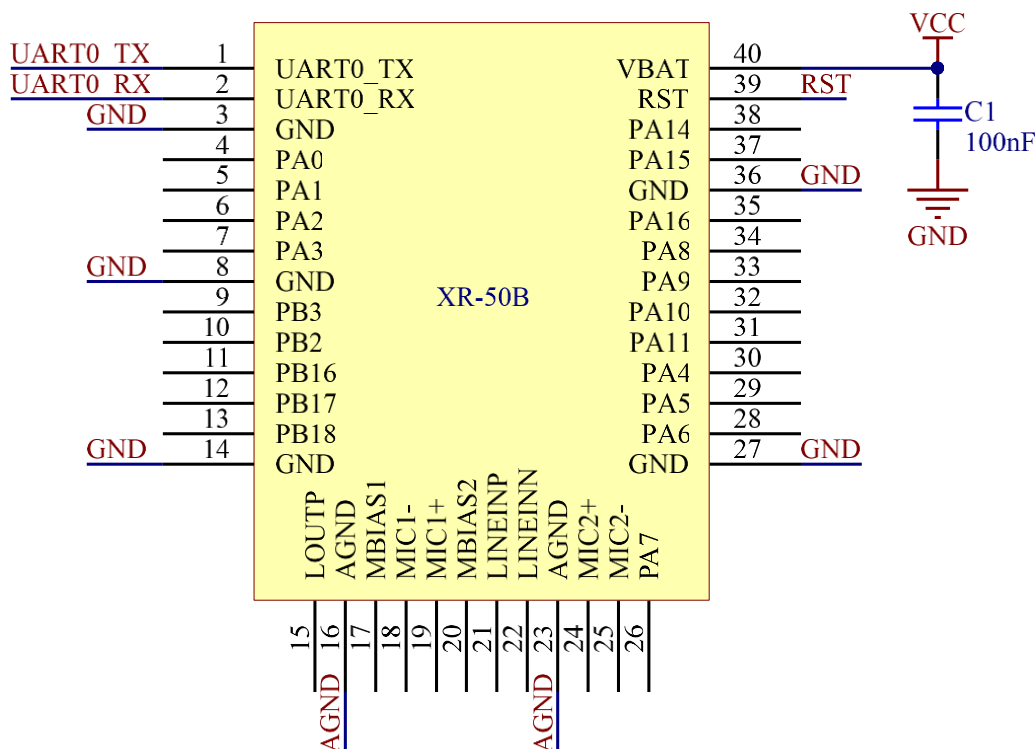


## 4. 回流焊曲线图



## 5. 典型应用

模组最小系统电路图如下:



只需要给模块提供 3.3V/5V 电源电压, 无需其他额外器件即可工作, 注意, 当使用 5V 供电时, IO 电压仍为 3.3V。

## 6. 联系我们

地址：广东省深圳市宝安区西乡索佳科技园商务大厦 5 楼 A505

联系电话：0755-23220940

网址：[www.aimachip.com](http://www.aimachip.com)